

EPMOLD MP65

环氧修补膏

应用

EPMOLD MP65 是用于 EP65 和 EP72 表面的快固环氧修补膏。MP65 操作时间短、固化快，专为 EP65/EP72 挤出糊状代木修补设计。

物理性能

	测试标准	树脂	固化剂
质量混合比		100	100
外观	目视	膏状	膏状
颜色	目视	灰色	白色
25°C 时的比重 (g/cm ³)	ISO1675:1985	约0.64	约0.76
25°C 时固化产物的比重	ISO2781:1996	约0.70g/cm ³	
25°C 时的可操作时间(500g)		约20min	
25°C 时可铣削加工的时间		约4hours	

力学性能

性能	测试标准	EPMOLDMP65
硬度	ISO868:2003	邵D65±2
弯曲强度	ISO178:2001	≥15MPa
压缩强度	ISO604:2002	≥20 MPa
玻璃化转变温度T _g	ISO11357:2002(DSC)	≥55°C
线膨胀系数	ISO11359-2:1999	45±5*10 ⁻⁶ K ⁻¹

(1) 标准试样测得的平均值 / 固化条件:40°C 10hrs

操作指南

1)按正确比例称量树脂和固化剂，手工充分混合并立即使用。建议在可操作时间的三分之二内完成施工，防止材料变硬而无法使用或失去浸润性，降低固化材料与修补膏之间的粘接。

05-2026 EPMOLD MP65 环氧修补膏 第 1/ 2 页

2)为确保 MP65 与原 EP65 表面良好粘接，应加深缺口并设计为锥形，使铣削后 MP65 至少保留 4 mm 厚度。铺覆新的 MP65 前，应在原 EP72 上涂覆积层树脂，加强两者粘接。

3)室温下固化约 4 小时后可进行机加工。

包装规格

EPMOLDMP65 树脂	EPMOLDMP65 固化剂
7kgx3	7kgx3

保质期与储存

两组分在 15 至 25°C 的干燥环境中以原包装未开封储存，保质期均为 12 个月。低温储存会变硬、难以混合，建议加热至 40-60 °C，直至软化到易于混合的程度。加温不会影响最终产品性能。开封容器使用后必须立即严密封闭。

安全注意事项

操作本产品时应遵守常规健康与安全措施:确保通风良好，佩戴手套和护目镜。详情请参阅产品安全数据表。

安全注意事项

应在通风良好的室内加工。加工时避免皮肤接触，佩戴手套、口罩、护目镜和防护服。详情请参阅材料安全数据表。

注意事项

上述数据是在特定条件下测得的。实际应用中的加工流程和条件可能有所不同，因此建议在使用前按需进行试验，确认产品满足实际要求。EPTEK 保证产品符合本公司的严格质量管理规范。

05-2026 EPMOLD MP65 环氧修补膏 第 2/ 2 页